

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】令和 2 年 4 月 9 日 (2020.4.9)

【公開番号】特開 2019-78707 (P2019-78707A)
 【公開日】令和 1 年 5 月 23 日 (2019.5.23)
 【年通号数】公開・登録公報 2019-019
 【出願番号】特願 2017-207839 (P2017-207839)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 35/08 (2006.01)

G 0 1 N 37/00 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 35/08 A

G 0 1 N 37/00 1 0 1

【手続補正書】
 【提出日】令和 2 年 2 月 28 日 (2020.2.28)
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

樹脂からなる第 1 の基板および樹脂からなる第 2 の基板が接合されてなり、少なくとも第 1 の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度 θ_1 が、 $\theta_1 > 90^\circ$ を満足し、

前記接合面、および前記第 2 の基板における前記第 1 の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が $500\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とするマイクロチップ。

【請求項 2】

前記非接触部の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度 θ_2 が、 $\theta_2 > 90^\circ$ を満足することを特徴とする請求項 1 に記載のマイクロチップ。

【請求項 3】

樹脂からなる第 1 の基板および樹脂からなる第 2 の基板が接合されてなり、少なくとも第 1 の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面および前記非接触部の側壁面の少なくとも一方において、当該側壁面に連続する接合面に接近した箇所が C 面取り形状または R 面取り形状とされており、

前記接合面、および前記第 2 の基板における前記第 1 の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が $500\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とするマイクロチップ。

【請求項 4】

前記第 1 の基板および前記第 2 の基板の周縁部の少なくとも一部において、当該第 1 の基板と当該第 2 の基板との接合部が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項

3 のいずれか一項に記載のマイクロチップ。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

本発明のマイクロチップは、樹脂からなる第 1 の基板および樹脂からなる第 2 の基板が接合されてなり、少なくとも第 1 の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度 θ_1 が、 $\theta_1 > 90^\circ$ を満足し、

前記接合面、および前記第 2 の基板における前記第 1 の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が $500\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

また、本発明のマイクロチップは、樹脂からなる第 1 の基板および樹脂からなる第 2 の基板が接合されてなり、少なくとも第 1 の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面および前記非接触部の側壁面の少なくとも一方において、当該側壁面に連続する接合面に接近した箇所が C 面取り形状または R 面取り形状とされており、

前記接合面、および前記第 2 の基板における前記第 1 の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が $500\ \mu\text{m}$ 以上であることを特徴とする。